

リフロー装置によるリフロー実装性評価と 実装後の故障解析評価のご案内

欧州での電気・電子機器に使用する鉛入りはんだの使用を制限または禁止する環境規制に端を発して、鉛フリーはんだのはんだ付け技術の向上と信頼性の検討の要望が高まっています。弊社では、はんだ付け工程の確認や改善をサポートする目的で、**リフロー実装性評価試験**ならびに**欠陥部の故障解析評価**を実施しております。故障解析のプロが、品質向上に役立つ改善提案を致します。

評価解析から故障解析まで

実装欠陥の故障解析まで一貫しておまかせ下さい！

はんだ接合部の断面観察をはじめとして、欠陥部の不良解析、分析を行っておりますので是非ご利用下さい。

リフロー実装性の評価に！

鉛フリーはんだの濡れ性評価にもご利用下さい。

評価試験の前処理に！

(熱履歴のシミュレーション)

実装工程の熱履歴を加えた後での信頼性評価が重要です。評価試験の精度アップにご利用下さい。



リフロー装置

リフロー装置の特徴

1. 鉛フリーはんだに有効：**加熱5ゾーン**によりリフローゾーンの2段階加熱が可能。
ピーク温度を抑えて、はんだ溶融時間を長くとれます。
2. 高密度実装基板のリフローに最適：**上下独立の熱風循環方式**のため、部品間温度差 (Δt) をより小さくすることが出来ます。
3. BGA,CSP の高精度部品実装、はんだボール形成用にも使用可能：**N₂発生装置**や**酸素濃度自動コントロール**、**温度プロファイルモニター**により、高温域でのはんだ酸化を抑制し、細部の温度プロファイルを実現しながら信頼性の高い部品実装が可能です。

お問い合わせ先

Chemitox 株式会社ケミトックス

URL:<http://www.chemitox.co.jp>

東京本社/〒145-0064 東京都大田区上池台 1-14-18

Tel: 03-3727-7111/Fax: 03-3728-1710

電子回路安全・信頼性技術部 営業技術担当
渡邊 (h-watanabe@chemitox.co.jp)